



Panasonic Electronic Materials Division launches a new product brand for the Semiconductor Device Materials business. The IC substrate materials' brand is transitioning from MEGTRON GX to LEXCM GX. パナソニック 電子材料事業部は、新たに半導体デバイス材料の製品ブランドを LEXCM (レクシム) としてスタートします。それに伴い、半導体パッケージ基板材料は MEGTRON GX から LEXCM GX へ変更いたします。

Low CTE IC substrate materials

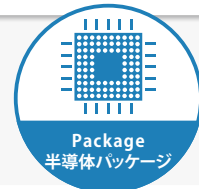
低熱膨張半導体パッケージ基板材料

LEXCMGX

Laminate **R-1515A**
Prepreg **R-1410A**

Applications 用途

IC substrate
半導体パッケージ基板



Achieve more functionality (multi-pin and integrated circuit) the large-sized Package by excellent modulus and highly heat resistant property.

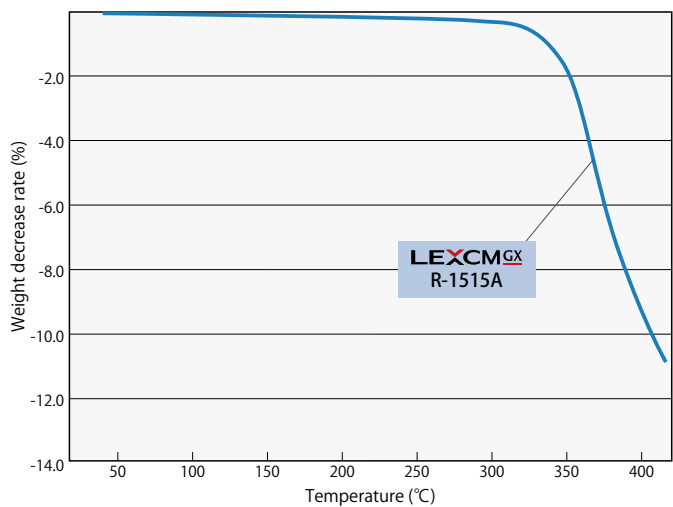
優れた弾性と耐熱性を有し、多ピン化・伝送回路集積化に伴う大型パッケージの高機能化に貢献

Flexural modulus
25°C 27GPa

CTE x, y-axis
11-13ppm/°C

Tg (DMA)
205°C

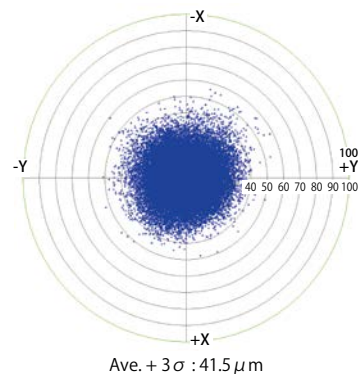
Heat resistance 耐熱性



Weight decrease @260°C

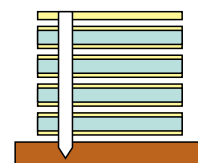
LEXCMGX R-1515A	0.2%
-----------------	------

Positioning accuracy 穴位置精度



Condition

Drill size	0.15mm φ
Flute length (ℓ)	3.0mm
Spindle speed	200krpm
Chip load	10 μm/rev
Hit count	20,000
Entry board	LE 800
Board thickness	0.4mm
Copper foil thickness	12/12 μm
Stack count	4



General properties 一般特性

Item	Test method	Condition	Unit	LEXCMGX R-1515A
Glass transition temp.(Tg)	DMA*2	A	°C	205
Thermal decomposition temp.(Td)	TGA	A	°C	390
CTE x-axis	α 1 Internal method	A	ppm/°C	11-13
CTE y-axis				11-13
Flexural modulus*1	JIS C 6481	25°C	GPa	27
		250°C		10

The sample thickness is 0.1 mm.
*1 0.8mm *2 measurement in bending mode

Our Halogen-free materials are based on JPCA-ES-01-2003 standard and others. 当社ハロゲンフリー材料は、JPCA-ES-01-2003などの定義によるものです。The above data are typical values and not guaranteed values. 上記データは当社測定による代表値であり、保証値ではありません。

Please see the page for "Notes before you use" 商品のご採用に当たっての注意事項は [こちら](#)

